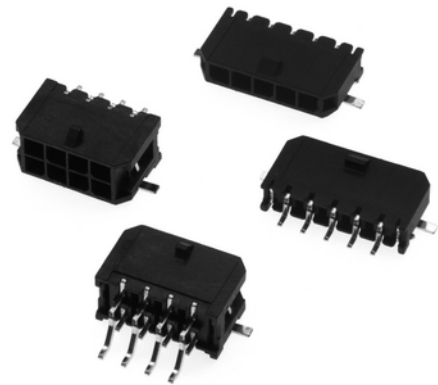


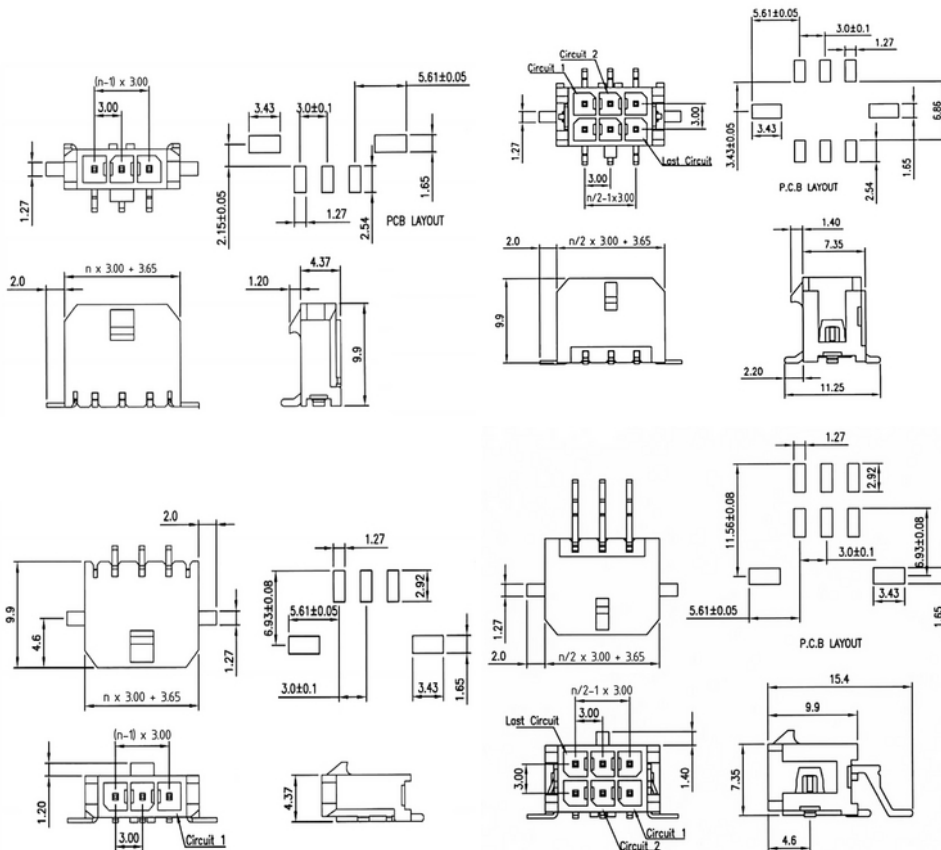
## SMT-Crimp-Rast-Stiftleiste stehend liegend 1-/2-reihig RM 3,00mm SMT Header 3,00mm Pitch

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, CuZn30
Contact Material	Square pin 0.635mm, CuZn30
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1GΩ
Insulation Resistance	> 1GΩ
Spannungsfestigkeit	1500V <sub>AC/DC</sub> max.
Test Voltage	1500V <sub>AC/DC</sub> max.
Nennstrom	5A
Current Rating	5A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS



Series

**5830**

Contacts\*

**12**

02-12 Einreihig  
Single row  
02-24 Zweireihig  
Double row

Type\*

**2**

1 Einreihig gerade  
Straight single row type  
2 Zweireihig gerade  
Straight double row type  
3 Einreihig gewinkelt  
Right-angled single row type  
4 Zweireihig gewinkelt  
Right-angled double row type

Plating

**50**

50 Verzinkt  
Tin plated

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Information

### Reflow-Löttempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8 min

